

DRAHTBONDSEMINAR TEIL 4 – ZULIEFERERQUALITÄT BONDOBERFLÄCHEN, SCHICHTANALYTIK, FEHLERBILDER

In Teil 4 dreht sich alles um Bondoberflächen – angefangen bei Schichtabscheideprozessen für unterschiedlichste Endmetallisierungen insbesondere Leiterplattenoberflächen, galvanisch abgeschiedene Oberflächen, gesputterte Oberflächen ebenso wie gedruckte Pasten. Sie erfahren, wie diese Schichten hergestellt werden, was sie voneinander unterscheidet und wie die Schichten typischerweise spezifiziert sein müssen, um als bondbar zu gelten.

Im zweiten Teil erfahren Sie, welche Fehler bei der Abscheidung dieser Schichten auftreten und wie diese durch systematische Analytik ermittelt werden können. Dazu werden die Analyseverfahren im Detail beleuchtet und vorgeführt. Die Methodik, wie mittels Qualitätstest beim Drahtbonds und entsprechender lichtmikroskopischer Analytik derartige Fehler einzugrenzen sind, wird ebenfalls thematisiert und vorgestellt.

Das Seminar ist in Theorie- und Praxisblöcke unterteilt. Die Praxisdemonstration erfolgt in den Laboren des Fraunhofer IZM an industrietypischem Prozess- und Analyseequipment. Je nach Verfügbarkeit der entsprechenden Anlagen, werden die Prozesse live demonstriert.

Für einen ersten Blick und eine unabhängige und unverbindliche Einschätzung, können eigene Proben mitgebracht werden. Diese werden während des Seminars an geeigneter Stelle diskutiert, so dass alle Teilnehmer an den Erkenntnissen der Diskussion teilhaben können.

Ihr Lernerfolg

Wenn Sie das Seminar erfolgreich abgeschlossen haben, wissen Sie:

- was die einzelnen Bondoberflächen und deren Schichtsysteme voneinander unterscheidet
- wie sich die Herstellprozesse gegeneinander abgrenzen
- welche Fehler passieren können
- mit welcher Systematik Sie an die Fehleranalytik herangehen

Zielgruppe

- Prozessentwicklung
- Produktentwicklung
- Qualitätsverantwortliche
- SQM-Verantwortliche

Ihre Vorteile

- weniger Zeit und Kostenverluste durch zielgerichtetere Analysen
- effektivere Abstimmungsprozesse durch breites Wissen im Unternehmen
- Praxiswissen aus anderen Blickwinkeln

 2 Tage


 4-6 Teilnehmer

 1.970 €*
pro Teilnehmer

*Preisangaben pro Teilnehmer und zzgl. gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer

Informationen / Anmeldung unter:

 www.bond-iq.de

 +49 30 46069009

 seminaranfrage@bond-iq.de

 Fraunhofer
IZM

 BOND-IQ

DRAHTBONDSEMINAR TEIL 4 – ZULIEFERERQUALITÄT

BONDOBERFLÄCHEN, SCHICHTANALYTIK, FEHLERBILDER

	Tag 1	Tag 2
09:00	Begrüßung und Vorstellung	Analysemethoden für Schichtsysteme
09:30	Schichtsysteme für Bondanwendungen im Überblick	
10:00	Stromlose und galvanische Schichtabscheideprozesse	Fehlerbilder in Schichtabscheideprozessen und Baugruppen
10:30		Praxis: Schichtdickenanalytik (RFA) FIB/REM-Analyse Querschlißpräparation
11:00	Praxis: ENIG/ENEPIG – Prozessanlage	
11:30	Mittagessen	Mittagessen
12:00	Pastenmetallisierungen auf Keramiksubstraten	Schichtprüfung durch Bondtests
12:30		
13:00	Dünnschichtmetallisierungen	Fallstudien
13:30	Schicht- und Oberflächenkombinationen	
14:00		14:30
14:30	15:00	
15:00	15:30	
15:30	16:00	

Ihre Referenten

- Stefan Schmitz
// Bond-IQ GmbH
// Drahtbond-Technologie & Trainer
// Geschäftsführer Bond-IQ
- Ralf Schmidt
// Fraunhofer IZM
// Wissenschaftler & Technologie




Equipment

- F&S Bondtec 5610, 5630, 5650, 5632
- F&S Bondtec 5810, 5830, 5850
- Pulltester 100 g bis 5 kg
- Schertester 500 g bis 50 kg
- Lichtmikroskop 100x bis 1000x
- Stereomikroskop bis 60x
- Fisherscope RFA
- ENIG/ENEPIG Prozessanlage
- FIB/REM-Anlage
- Querschliß-Labor

Hotelempfehlungen für Sie

- Hotel Grenzfall
Ackerstraße 136
13355 Berlin
Tel.: +49 30 34333300
www.hotel-grenzfall.de
- Mercure Hotel Berlin City
Invalidenstraße 38
10115 Berlin
Tel.: +49 30 308260
- Hotel Motel One Berlin Alexanderplatz
Dircksenstraße 36
10179 Berlin
Tel.: +49 30 20054080

Informationen / Anmeldung unter:

-  www.bond-iq.de
-  +49 30 46069009
-  seminaranfrage@bond-iq.de